

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES  
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum  
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum  
12. Mai 2005 (12.05.2005)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer  
**WO 2005/043970 A1**

(51) Internationale Patentklassifikation<sup>7</sup>: **H05K 7/20**,  
H01G 9/08, 2/08, H01M 8/02, 8/12, H01C 1/084

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): REGENFUS, Lothar  
[DE/DE]; Erlachweg 2, 91077 Neunkirchen (DE).

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2004/052685

(74) Gemeinsamer Vertreter: SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT; Postfach 22 16 34, 80506 München (DE).

(22) Internationales Anmeldedatum:  
28. Oktober 2004 (28.10.2004)

(81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

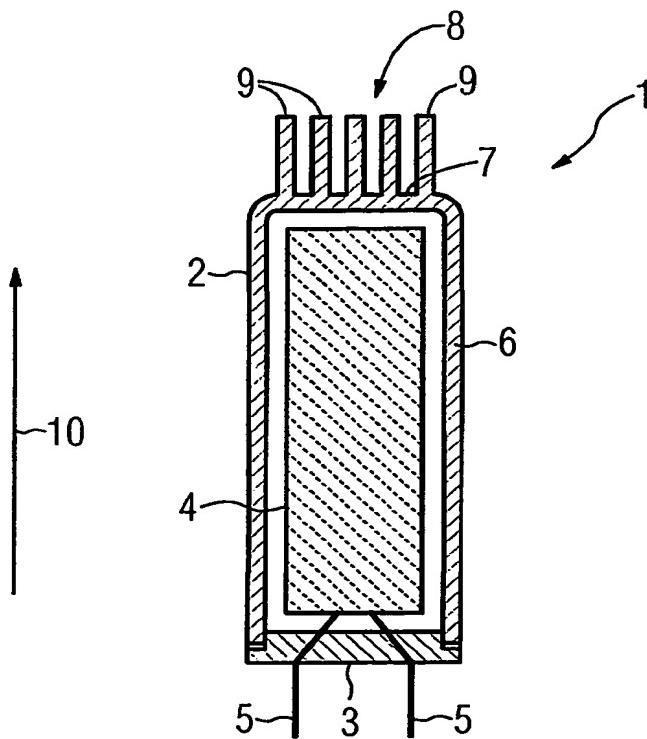
(25) Einreichungssprache: Deutsch  
(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch  
(30) Angaben zur Priorität:  
103 50 896.1 31. Oktober 2003 (31.10.2003) DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT [DE/DE]; Wittelsbacherplatz 2, 80333 München (DE).

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: HOUSING CUP FOR AN ELECTRONIC COMPONENT WITH INTEGRATED COOLING BODY

(54) Bezeichnung: GEHÄUSEBECHER FÜR EIN ELEKTRONISCHES BAUTEIL MIT INTEGRIERTEM KÜHLKÖRPER



(57) Abstract: According to the invention, the cooling capacity of an electronic component (4) may be improved with simple means, whereby the electronic component (4) is provided with a housing cup (2), produced by an extrusion method, the cup base (7) of which is formed to give a cooling body (8), integral with the housing cup (2).

(57) Zusammenfassung: Um mit einfachen Mitteln die Wärmeabgabefähigkeit eines elektronischen Bauteils (4) zu verbessern, ist das elektronische Bauteil (4) mit einem durch Fließpresstechnik hergestellten Gehäusebecher (2) versehen, dessen Becherboden (7) zu einem mit dem Gehäusebecher (2) einstückigen Kühlkörper (8) ausgeformt ist.

WO 2005/043970 A1



(84) **Bestimmungsstaaten** (*soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare regionale Schutzrechtsart*): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

— vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche geltenden Frist; Veröffentlichung wird wiederholt, falls Änderungen eintreffen

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("*Guidance Notes on Codes and Abbreviations*") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

**Veröffentlicht:**

— mit internationalem Recherchenbericht